

各 位

2020 年 11 月 10 日

令和 2 年度 近畿地方発明表彰 特許庁長官賞受賞について

TOWA 株式会社では、このたび公益社団法人発明協会主催の令和 2 年度近畿地方発明表彰において、当社開発本部装置開発部の水間敬太テクニカルリーダーが特許庁長官賞を受賞しましたので、お知らせします。

この表彰は、実施効果が高く、科学技術の向上および地域産業の向上に貢献していると認められる発明を表彰するものです。

受賞の対象となったのは、TOWA の主力製品であるコンプレッション装置における半導体樹脂封止（モールドイング）過程で、樹脂粉末の飛散を防止し、樹脂カス等の異物のない従来よりも高品質の製品を生産することを可能にする発明で、2018 年 3 月に特許登録されました。

【発明の説明】

コンプレッション装置では、離型フィルムに半導体封止用樹脂を乗せて金型まで搬送します。そして、金型上で樹脂を溶融させ、そこに半導体基板を浸して封止します。

従来は、搬送の過程で樹脂保持用の枠（トレイカバー）と離型フィルムとの間に樹脂が入り込み、トレイカバーや離型フィルムの不必要な個所に樹脂が付着していました。その付着した樹脂が異物となり生産される製品（樹脂封止された半導体チップ）の品質を低下させる原因となっていました。

そこで、トレイカバーへの樹脂の入り込みを防止する部品を取り付け、不必要な個所に樹脂が付着しないようにしました。その結果、供給される樹脂量も安定し品質向上に繋がりました。

詳しい説明は、下記をご覧ください（公益社団法人発明協会ホームページ）。

http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/R2/jusho_kinki/detail/jpo2.html

この発明は、日本のみならず、中国、韓国、台湾でも特許を取得しています。

また、本特許を実施した実績により、代表取締役社長 岡田博和が「実施功績賞」(注)を受賞しました。

(ご参考) 令和 2 年度近畿地方発明表彰受賞者一覧（公益社団法人発明協会ホームページ）

http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/R2/jusho_kinki/index.html

以 上

(注) 文部科学大臣賞、特許庁長官賞等の対象となった発明等が法人によるものであり、その実施に顕著な功績があったと認められる当該法人の代表者に贈呈される賞

問合せ先：TOWA 株式会社 企画部

TEL (075)692-0251